



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

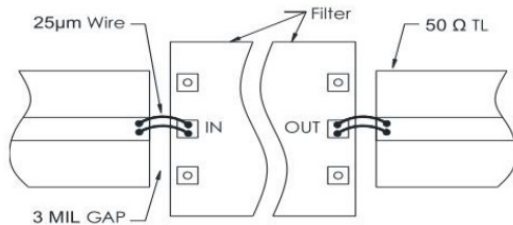
技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.0		GHz
工作频率	7.5		12.5	GHz
中心损耗		1.6	2.1	dB
带内波动		1.0	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-4.5GHz	40	45	dBc
	@14.2-22.5GHz	40	45	dBc

环境要求

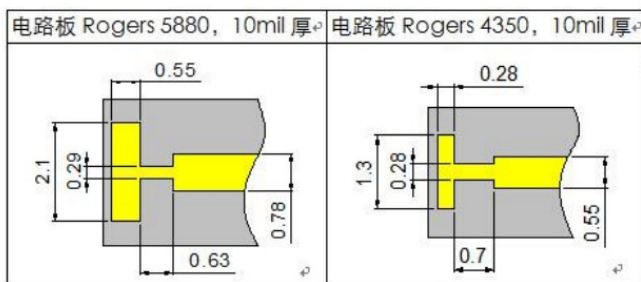
最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图



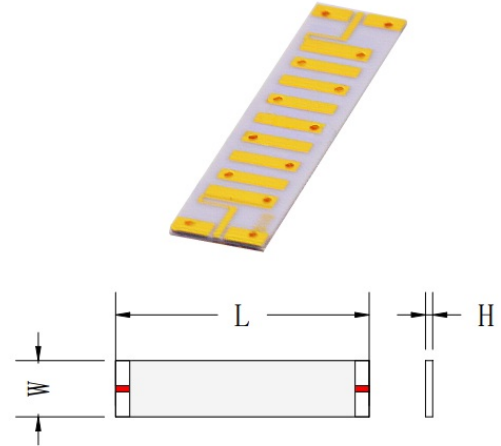
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度≥0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



注: T型图形顶端基板白边0.1mm; 频率10GHz以下无需匹配。
注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	7.0	4.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

